

# 片式磁珠(SMD阵列) 一般信号线用

RoHS指令对应产品

## MZA系列 MZA1608型

### 特点

- 1片可用于4线的噪音对策，最适用于手机等要求更高安装密度的电子设备的输入/输出线噪音对策。
- 可将相邻电路间的串扰抑制在较低程度。
- 内部电极采用低直流电阻结构，不发生多余的功耗浪费。
- 端子电极已经过电镀，可适用回流焊接的任意一种焊接工法。
- 采用完全单片结构，实现了高可靠性。
- 为RoHS指令对应产品。

### 用途

用于电脑，打印机，VTR，电视机，手机等。

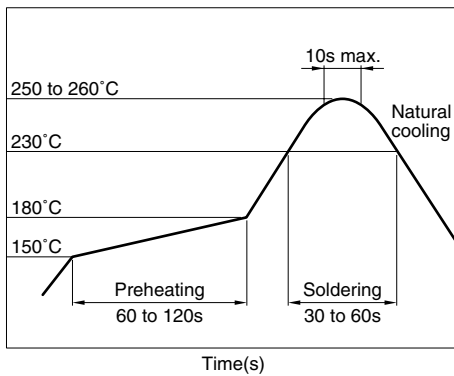
### 产品名称的识别法

MZA 1608 S 121 C T  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

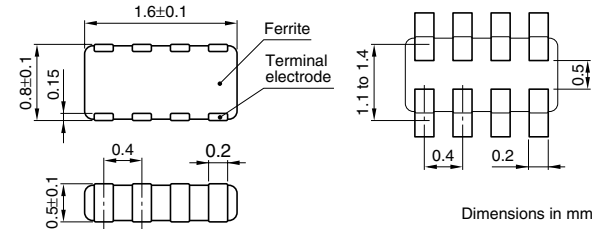
- (1) 系列名称
- (2) 尺寸 L×W
- (3) 使用材质名称
- (4) 公称阻抗  
121:120Ω at 100MHz
- (5) 类别
- (6) 包装形式  
T:卷带

### 推荐焊接条件

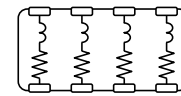
#### 回流焊接施工方法



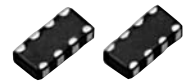
### 形状・尺寸 / 推荐印刷电路板图样



### 电路图



- No polarity



### 温度范围

动作时 / 保存时 -55 to +125°C

### 包装形式 / 包装个数

包装形式	个数
卷带	4000 个 / 1 卷

### 使用注意事项

- 在实施焊接前，请务必进行预热。预热温度与焊接温度及本产品温度的温度差要在150°C以内。
- 在将安装有本产品的印刷电路板组装到框架等组件中时，请注意不要让电路板因螺丝紧固造成局部变形而使本产品承受残余应力。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 因进行电路修正而使用焊接烙铁时，请将烙铁头温度保持在350°C以下，并将其放在电路板的铜箔部分上3秒钟以内完成。
- 本产品不对应回流焊接施工方法。

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

● 要在产品故障和误动作与人身安全直接相关的设备（汽车，飞机，医疗设备，核装置等）上使用这些产品时，请咨询本公司营业部门。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

## 电气特性

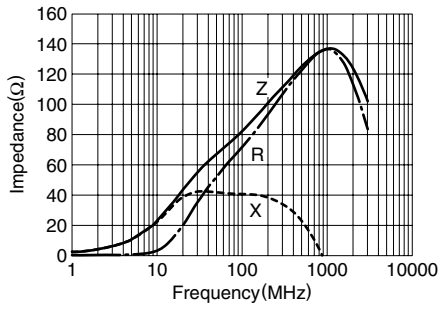
品名	阻抗 ( $\Omega$ )[100MHz]*	直流电阻 最大 ( $\Omega$ )	额定电流 最大 (mA)
MZA1608S800C	80 $\pm$ 25%	0.35	150
MZA1608S121C	120 $\pm$ 25%	0.4	150
MZA1608S241C	240 $\pm$ 25%	0.5	150

\* 测定器：E4991A 或其同等品  
 测定治具：16192A 或其同等品  
 测定温度：25 $\pm$ 10 $^{\circ}$ C

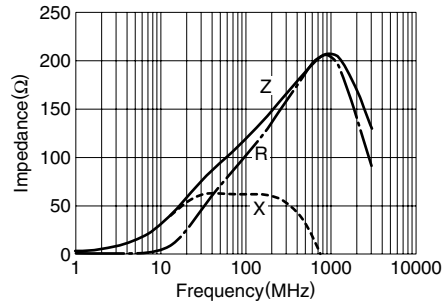
## 电气特性例

### Z, X, R 频率特性

#### MZA1608S800C



#### MZA1608S121C



#### MZA1608S241C

